

國立金門大學 電子工程學系學士班 課程規劃表

106 學年度入學新生適用

本學系學生畢業時至少應修滿 135 學分，包括			修訂歷程		
共同必修 10 學分	通識課程 16 學分	專業實習 6 學分			
院必修 3 學分	系必修 58 學分				
專業選修 42 學分(包括 6 學分可選修非本學系所開設之課程)					

	一年級	上學期		下學期		二年級	上學期		下學期		三年級	上學期		下學期		四年級	上學期		下學期		四年合計		
		學分	時數	學分	時數		學分	時數	學分	時數		學分	時數	學分	時數		學分	時數	學分	時數		學分	時數
共同必修	通識	依本校「學生修習通識教育課程辦法」規定。																				16	
	專業實習	依本校「日間部大學部專業實習課程開設準則」規定，開課時間於一下起，各系得依需求開設。																				6	
	體育	依本校「體育課程實施辦法」規定。																				0	
	國文(一)	2	2																				10
	英文(一)	2	2																				
	服務教育	0	1																				
	金門學概論	2	2																				
	國文(二)			2	2																		
英文(二)			2	2																			
服務教育			0	1																			
共同必修總計																						32	
專業必修	院必修	微積分	3	3																			
	院必修總計		3	0				0	0				0	0				0	0			3	
	系必修	普通物理實驗(一)	1	3			電子電路實習(一)	1	3			電子學(三)	3	3									
		普通物理學(一)	3	3			電子學(一)	3	3			通訊原理	3	3									
		邏輯設計與實習	3	5			電路學(一)	3	3			信號與系統	3	3									
		工程材料概論	3	3			工程數學(一)	3	3														
		計算機與網際網路概論	3	3			電磁學			3	3												
		微積分(二)			3	3	電子電路實習(二)			1	3												
		普通物理學(二)	3	3			電子學(二)			3	3												
		普通物理實驗(二)	1	3			電路學(二)			3	3												
		機率			3	3	工程數學(二)			3	3												
		資料結構與程式設計			3	5																	
	系必修總計			13	13				10	13				9	0				0	0			58
專業必修總計			16	13				10	13				9	0				0	0			61	
共同選修											科技新聞導讀	2	2			專題研究(一)	2	2					
											科技新聞翻譯			2	2	工程倫理	3	3					
											科技論文寫作			1	1	校外專業實習(一)	4	4					
											線性代數			3	3	專題研究(二)			2	2			
																企業實務培訓			3	3			
																校外專業實習(二)			4	4			
	能源與固態領域						固態分析技術			3	3	半導體製程技術	3	3			再生能源薄膜工程						
												電漿技術	3	3			新能源技術	3	3				
												半導體元件及物理			3	3	能量轉換原理	3	3				
												表面工程			3	3	太陽能電力電子系統	3	3				
												感測器實務			3	3	太陽能電力系統			3	3		
																	太陽能技術			3	3		
	通訊與訊號處理領域	數位系統設計			3	3	工程模擬軟體			3	3	數值分析	3	3			數位影像處理	3	3				
							物件導向程式設計			3	3	數位信號處理概論			3	3	數位信號處理實驗	3	3				
							計算機結構			3	3	數位通訊導論			3	3	高等通訊系統模擬與實驗	3	3				
												通訊實驗			3	4	模式化通訊IC設計	3	3				
												電腦網路			3	3	編碼理論			3	3		
												傳輸系統電路設計與模擬			3	3	品質工程			3	3		
																高頻電路佈局與模擬			3	3			
IC設計與應用領域						微處理器系統與實驗			3	3	FPGA系統設計實務	3	3			射頻積體電路與模擬	3	3					
						單晶片原理應用			3	3	嵌入式系統概論	3	3			超大型積體電路設計	3	3					
						硬體描述語言程式設計與模擬			3	3	機器人程式設計	3	3			通訊網路積體電路設計			3	3			
						機器人控制入門			3	3	半導體IC封裝測試工程技術(一)	2	2			鎖相迴路設計與應用			3	3			
						電腦輔助電路設計			3	3	超大型積體電路設計導論	3	3			電力電子積體電路設計與模擬			3	3			
											前瞻性類比積體電路佈局設計			3	3	類比積體電路設計與模擬	3	3					
專業選修總計			0	3				12	15				25	38				36	39			168	
學期總計			16	16				22	28				34	38				36	39				

備註：

- 一、畢業總學分135學分，共同必修 32學分[含通識課程16學分(由通識中心規劃)]，專業必修(含院必修及系必修) 61學分，選修學分包含6學分可選修非本系所開設之課程，且須通過「本校學生英文及資訊能力畢業門檻及輔導辦法」相關規定始可畢業。
- 二、已修習通訊原理方可選修數位通訊導論、數位通訊系統、通訊實驗。已修習信號與系統方可選修數位信號處理概論。已修習微積分(一)方可修習微積分(二)。
- 三、院必修微積分即為本系必修微積分(一)。
- 四、「專題研究(一)」得抵修「專業實習(三)」。
- 五、碩班任一學期「專題討論」得抵修任一學期「專業實習」。
- 六、學士班四年級課程與碩士班課程名稱相同時，課程同時適用碩士班。
- 七、表列選修科目為預定科目，將視實際需要而調整。
- 八、「計算機概論」得抵修「計算機與網際網路概論」；「材料科學與工程導論(一)」得抵修「工程材料概論」。
- 九、「數位邏輯」、「數位邏輯實習」任一門得抵修「邏輯設計與實習」、「資料結構」、「程式設計」任一門得抵修「資料結構與程式設計」。